

HRG300

High Rigid Grinder

高剛性研削盤

短時間でダメージのない加工を実現

低加工コスト

バッチ加工で高精度研削が可能

常時ドレスの精研削プロセス（オプション）



株式会社東京精密



対象材料

サファイヤ SiC GaN ALN等の難削材

対象ワーク

サイズ：φ2～φ12インチ
最大厚さ：20mm（支持基板の厚さを含む）

加工事例

材料	サイズ	枚数/バッチ	取代	加工時間
サファイア	4インチ	4枚バッチ	530μm	10分(2分30秒/枚)
SiC	4インチ	枚葉	120μm	1分
窒化アルミナ	6インチ	枚葉	500μm	4分

仕様



項番	項目	ACCRETECH
		高剛性研削盤
1	外観 (mm)	サイズ：1540(W)X 1880(D)X 2010(H) 重さ：3700kg
2	最大加工径 (mm)	300
3	砥石径 (mm)	300
4	砥石軸回転数 (rpm)	3600
5	ワーク軸回転数 (rpm)	400
6	砥石軸モータ (Kw)	11
7	ワーク軸モータ (Kw)	2
8	自動計測	インプロセスゲージ採用 (バッチ処理対応)
9	送り制御最小分解能 (μm)	0.1
10	常時ドレス機能	オプション

株式会社東京精密

お問合せはお近くの取扱店まで

<http://www.accretech.jp/>

■ 半導体製造機器取扱営業所

東京営業所 (042) 631-5211 (042) 631-5234
大阪営業所 (06) 6821-0361 (06) 6821-0210
九州営業所 (097) 538-1985 (097) 538-1989

■ 半導体製造機器サービスステーション

仙台出張所 (022) 224-0177 (022) 224-7083
山形出張所 (023) 631-5125 (023) 625-4129
鶴岡出張所 (0235) 29-8020 (0235) 29-8022
東京CE課 (042) 642-0358 (042) 642-0367
東京CE課/土浦出張所 (0298) 34-8550 (0298) 31-6808
四日市出張所 (0593) 61-6610 (0593) 66-2210
北陸出張所 (076) 422-6756 (076) 422-6757

大阪CE課 (06) 6821-0225 (06) 6821-0210
東広島出張所 (082) 493-5618 (082) 493-5619
熊本出張所 (096) 387-5188 (096) 386-1592
九州CE課 (097) 534-3291 (097) 538-1989
国分出張所 (0995) 43-2510 (0995) 43-2586
八王子パーツセンター (042) 642-0381 (042) 642-0397

■ 東精エンジニアリング

土浦事業所CEグループ (029) 830-1882 (029) 830-1881
土浦事業所パーツセンター (029) 830-1882 (029) 830-1881
名古屋事業所 (0561) 32-3605 (0561) 34-2744